

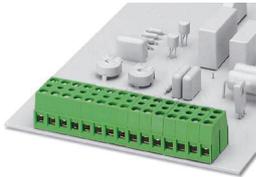
KDSP 1,5/ 2 - Borna para placa de circuito impreso



1780905

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1780905>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: KDSP 1,5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,7 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Sus ventajas

- El principio de conexión conocido permite el uso universal
- Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
- Permite la conexión de dos cables
- Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
- Fácil inserción en bucle de potenciales con conexión adicional para la placa de circuito impreso
- Los pines de soldadura dobles reducen la sollicitación mecánica de los puntos de soldadura
- El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos

Datos comerciales

Código de artículo	1780905
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AALFCB
Clave de producto	AALFCB
GTIN	4017918040949
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,094 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,09 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Terminal de tarjetas de circuitos impresos
Familia de productos	KDSP 1,5
Línea de productos	COMBICON Terminals S
Construcción	Borne para tarjeta alineable + borne de paso
Número de polos	2
Paso	5 mm
Número de conexiones	4
Número de filas	1
Número de potenciales	2
Diseño del pin	Disposición de pines lineal
Número de pines de soldadura por potencial	2

Propiedades eléctricas

Propiedades

Corriente nominal I_N	17,5 A
Tensión nominal U_N	400 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	320 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	4 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2)	400 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	4 kV
Tensión nominal (II/2)	630 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	4 kV

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Construcción	Borne para tarjeta alineable + borne de paso
Sección nominal	1,5 mm ²

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por tornillo con cápsula de tracción
Sección de conductor rígido	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor AWG	26 ... 16
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conductores con la misma sección, rígidos	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico	0,25 mm ²

KDSP 1,5/ 2 - Borna para placa de circuito impreso



1780905

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1780905>

2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Longitud de pelado	7 mm
Forma del accionamiento cabeza de tornillo	Ranura longitudinal (L)
Par de apriete	0,6 Nm ... 0,8 Nm

Montaje

Tipo de montaje	Soldadura por ola
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

Datos del material

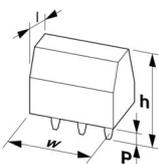
Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior)	Estaño (5 - 7 µm Sn)
Superficie de metal del punto de embornaje (capa intermedia)	Níquel (2 - 3 µm Ni)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior)	Estaño (5 - 7 µm Sn)
Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia)	Níquel (2 - 3 µm Ni)

Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	verde (6021)
Material aislante	PA
Grupo material aislante	I
CTI según IEC 60112	600
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Paso	5 mm
Anchura [w]	10 mm
Altura [h]	17,5 mm
Longitud [l]	18,8 mm
Altura total	13,8 mm
Longitud del pasador de soldadura [P]	3,7 mm
Dimensiones de patilla	0,9 x 0,9 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Diámetro orificio	1,3 mm
-------------------	--------

Ensayos eléctricos

KDSP 1,5/ 2 - Borna para placa de circuito impreso



1780905

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1780905>

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

Grupo material aislante	I
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)	320 V
Tensión transitoria nominal (III/3)	4 kV
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)	400 V
Tensión transitoria nominal (III/2)	4 kV
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)	630 V
Tensión transitoria nominal (II/2)	4 kV

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

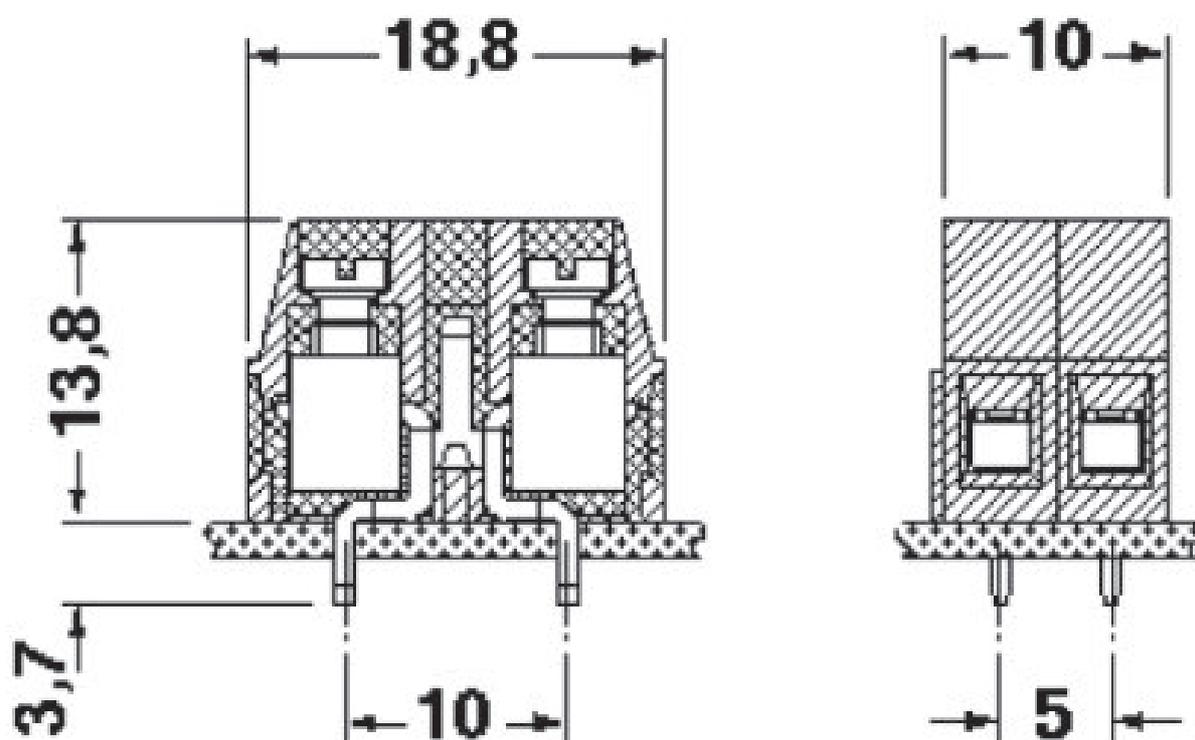
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C

Información sobre el embalaje

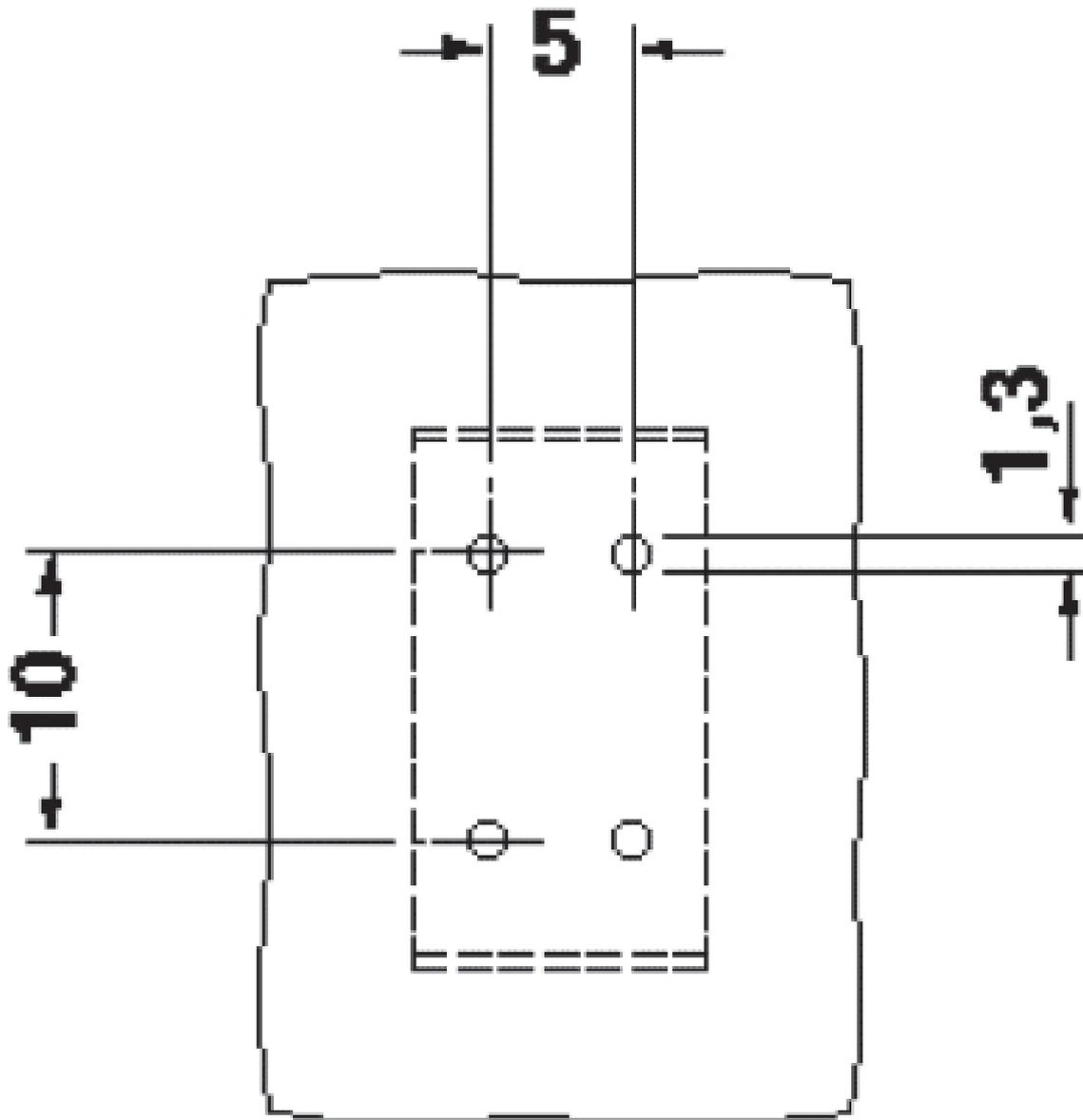
Tipo de embalaje	empaquetado en caja
------------------	---------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de taladros/geometría pads soldadura



KDSP 1,5/ 2 - Borna para placa de circuito impreso



1780905

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1780905>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1780905>

 cULus Recognized ID de homologación: E60425-19770427				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B	300 V	15 A	30 - 14	-
D	300 V	10 A	30 - 14	-

 CSA ID de homologación: 13631				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine	300 V	10 A	28 - 14	-

KDSP 1,5/ 2 - Borna para placa de circuito impreso



1780905

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1780905>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	Leiterplattenklemme
ECLASS-15.0	Leiterplattenklemme

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1780905

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1780905>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,059 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es